

Messen

TDK zeigt auf der PCIM und SENSOR+TEST ihre neuesten Lösungen für die grüne und digitale Transformation

- Unter dem Dachmotto „Accelerating transformation for a sustainable future“ präsentiert TDK vom 6. bis 8. Mai 2025 auf der NürnbergMesse ihre Highlight-Lösungen für den grünen und digitalen Wandel
- Auf der PCIM können Messebesucher am Stand 350 in Halle 9 die aktuellsten Lösungen bei passiven Bauelementen und Sensoren für Wind- und Solarenergie, ESS, Wasserstoff, Wärmepumpen, Elektromobilität (xEV), das Laden von Elektrofahrzeugen und KI erleben
- Auf der SENSOR+TEST können sich Messebesucher am Stand 204 in Halle 1 über die jeweils neuesten Sensortechnologien von TDK informieren, mit denen sich die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit industrieller und automobiler Lösungen optimieren lassen

28. April 2025

Die TDK Corporation präsentiert ihre jüngsten Innovationen bei Passiven Bauelementen und Sensoren auf der diesjährigen PCIM sowie der SENSOR+TEST, die vom 6. bis 8. Mai 2025 parallel auf der NürnbergMesse stattfinden. „Accelerating transformation for a sustainable future“ ist die gemeinsame Botschaft für beide Auftritte, in deren Rahmen Messebesucher die Lösungen von TDK für den grünen und digitalen Wandel in den Anwendungsbereichen Automobil, Industrie, Hausgeräte und künstliche Intelligenz erleben können. Auf der PCIM in Halle 9, Stand 350, präsentiert TDK passive Bauelemente und Sensorlösungen für Anwendungen wie Energie- und Leistungsumwandlung, Wärmepumpen, Ladung von Elektrofahrzeugen, Mobilität (xEV) und KI. Nur einen Katzensprung entfernt, in Halle 1, Stand 204, können interessierte Besucher auf der SENSOR+TEST das gesamte Spektrum der Sensortechnologien verschiedener Unternehmen der TDK Gruppe kennenlernen.

Wichtige Highlight-Lösungen auf der PCIM, Halle 9, Stand 350:

- **Elektromobilität (xEV):** TDK präsentiert eine Sammelschiene mit dem modularen xEVCap als DC-Link-Kondensator sowie ein bidirektionales 22-kW-Bordladegerät. Innovative induktive Bauelemente wie Transformatoren mit integrierter Drossel minimieren Verluste und sparen wertvollen Platz in Onboard-Ladegeräten. Durch Mehrschichtsubstrate aus Aluminiumnitrid (AlN) und 3D-gedruckte AlN-Flüssigkeitskühler lässt sich ein 400-kW-Traktionsumrichter auf gerade einmal zwei Spielkartenstapeln schrumpfen.
- **Energie- und Leistungsumwandlung (Wind, Solar, ESS, Wasserstoff usw.):** Zu sehen ist eine modulare Umrichterlösung auf Basis der CeraLink-Technologie als Flying Capacitors sowie ein 250-kW-Umrichter für Nutz- und Agrarfahrzeuge. Premiere feiert die nächste Generation des preisgekrönten ModCap; der ModCap High Performance kann bei erhöhten Temperaturen von +105 °C ohne Derating betrieben werden. Standbesucher können eine 60 kg schweren Wind Power Stack bewundern, der mit 15 Kondensatoren der Serie MKP DC HF im Zwischenkreis ausgerüstet ist. Der Ansteuerübertrager EP9 ist gerade einmal so groß wie ein Stück Würfelzucker und verfügt über eine Betriebsspannung von 500 V für das Ansteuern von IGBTs und MOSFETs auf der High-Side einer Halbbrücke.
- **Laden von Elektrofahrzeugen:** TDK präsentiert verschiedene Referenzdesigns wie einen bidirektionalen Onboard-Lader mit 22 kW sowie einen modularen Hybrid-Inverter für 10 + 15 kW. Neu sind auch mehrere Gleichspannungskondensatoren und Sicherheits-EMI-Kondensatoren sowie Hochspannungsschütze wie der HVC50 für Ströme bis zu 750 A bei 1500 V, die für Megawatt-Ladestationen gedacht sind.

- Sensorlösungen: Um die Kosten für Wärmepumpen deutlich zu senken, präsentiert TDK integrierte Druck- und Temperatursensoren. Und anhand eines realen Elektromotors veranschaulichen wir unser umfassendes Portfolio an Sensorlösungen, um den Motor maximal auszureizen, ohne ihn zu überlasten.

Präsentationen

- Niklas Edkvist, TDK Europe: Podiumsdiskussion „Powering AI: What Market and Technology Trends in Powertrain?“, 6. Mai um 11:20 Uhr auf der Technology Stage in Halle 4, Stand 435
- David Olalla, TDK Electronics: „Practical Use of xEVCap: The Modular and Standard DC-Link Capacitor for the Main Powertrain Inverter“, 8. Mai, 10:10 Uhr, Raum Mailand

Wichtige Highlight-Lösungen auf der SENSOR+TEST, Halle 1, Stand 204:

- Hall-Effekt-Sensoren für die Automobilindustrie: Standbesucher können mehr über die neuen gegen Streufelder resistenten 2D-Hall-Effekt-Sensoren HAL/R 35xy für Automobilanwendungen erfahren, beispielsweise für die Erfassung von Lenkradwinkeln, Brems- und Gaspedalen, Ventilpositionen und Fahrzeugchassis. Diese sind in den Single-Die- (HAL 3550) und Dual-Die-Versionen (HAR 3550) mit analogen und digitalen Ausgängen erhältlich.
- Eingebettete Motorsteuerungslösungen: TDK präsentiert auch das neue, kosteneffiziente programmierbare Gate-Treiber-SoC HVC 5481G für Aktuatoren, Lüfter und Pumpen in Automobilen. Es kann eine externe Leistungsbrücke aus sechs N-Kanal-FETs mit sensorbasierten und sensorlosen Algorithmen von der BEMF-Kommutierung bis zur Einzel-Shunt-FOC antreiben.
- Analoge und digitale MEMS-Mikrofone: Messebesucher können Lösungen für Audioerfassung und Erkennung von akustischen Aktivitäten und Sprachbefehlen näher kennenlernen.
- WeWALK Smart Cane 2: Erleben Sie den vielfach prämierten smarten Blindenstock, der mit Mikrofonen sowie Ultraschall- und Bewegungssensoren von TDK ausgestattet ist. Damit verbessert er die Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen, ohne Abstriche beim ergonomischen Design zu machen.
- Ultraschallsensoren: Mit dieser Lösung von TDK können autonome mobile Roboter (AMR) oder fahrerlose Transportsysteme (AGV) Objekte erkennen und Entfernungen in anspruchsvollen Umgebungen ermitteln, z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung, transparenten Zielobjekten und bei Vibrationen.
- Drucksensoren: Am Stand können Besucher mehr über kombinierte Druck- und Temperatursensoren für das Wärmemanagement sowie über Drucksensoren zur Erkennung von undichten Stellen an Treibstofftanks und für industrielle Anwendungen erfahren.
- Temperatursensoren: Zu sehen sind auch Oberflächen-Temperatursensoren für die Industrie sowie Lösungen für die Automobilbranche. Darunter fallen ein Sensor für die Sammelschiene von Elektromotoren, kleinformatige Lösungen für Elektromotoren, Clip-on-Bauelemente für Wärmepumpen und ein Sensor für hohe Spannungen.

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte TDK einen Umsatz von 14,6 Milliarden USD und beschäftigte rund 101.000 Mitarbeiter weltweit.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu können Sie unter https://www.tdk.com/de/news_center/press/20250428_04.html herunterladen.

Kontakt für Medien

		Telefon	Mail
Hr. Frank TRAMPNAU	TDK Management Services GmbH Düsseldorf, Deutschland	+49 211 9077 127	frank.trampnau@tdk.com